

杭州士兰微电子股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：成都士兰半导体制造有限公司（以下简称“成都士兰”）
- 增资金额：使用10,000万元募集资金对成都士兰进行增资。
- 本次增资事宜已经杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过。
- 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、 资金募集情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2005号），公司向6名特定对象非公开发行了人民币普通股64,893,614股，每股发行价为11.28元，募集资金总额为人民币731,999,965.92元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币26,405,660.37元，实际募集资金净额为人民币705,594,305.55元。该项募集资金已于2018年1月3日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2018〕1号《验资报告》。

二、 募集资金项目情况

根据公司《非公开发行股票预案》：

- 1、项目名称：年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目
- 2、项目投资：项目计划总投资80,253万元，拟使用募集资金投入80,000万元。
- 3、项目实施主体：MEMS传感器芯片制造扩产项目由控股子公司士兰集成负责具体实施，募集资金将通过公司向士兰集成增资的方式投入；MEMS传感器封装项目由全资子公司成都士兰负责具体实施，募集资金将通过公司向成都士兰增资的方式投入；MEMS传感器测试能力提升项目由本公司负责实施。

4、项目产品方案：三轴加速度计、六轴惯性单元、硅麦克风传感器、地磁传感器。

根据2018年1月23日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》：鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司拟调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	原拟投入募集资金金额	现拟投入募集资金金额
1	年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	80,253	80,000	70,559.43
1.1	其中：新增年产 15.9 万片 MEMS 传感器芯片扩产技术改造项目	37,900	37,647	30,568.43
1.2	MEMS 传感器产品封装生产线技术改造项目	22,362	22,362	20,000
1.3	MEMS 传感器测试能力提升项目	19,991	19,991	19,991
合计			不超过 80,000	70,559.43

募集资金不足的部分，公司将以自有资金或通过其他融资方式解决。

三、 承担募集资金项目子公司基本情况

- 1、公司名称：成都士兰半导体制造有限公司
- 2、成立时间：2010 年 11 月 18 日
- 3、注册地址：成都-阿坝工业集中发展区内
- 4、注册资本：60,000 万元
- 5、法定代表人：陈向东
- 6、经营范围：集成电路、半导体分立器件、发光半导体等半导体产品的设计、制造、销售；货物进出口。
- 7、股东情况：成都士兰为公司全资子公司，公司持有成都士兰 100%股权。

四、 使用募集资金增资

根据 2017 年 1 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会和 2017 年 4 月 17 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会以及第六届董事会第十六次会议审议通过的与公司本次非公开发行相关的议案和决议，按照募集资金项目投资资金需求和支出计划，公司拟用募集资金向承担募投项目之“MEMS 传感器产品封装生产线技术改造项目”的成都士兰半导体制造有限公司增资 10,000 万元。

公司于 2018 年 1 月 23 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。本次增资完成后，成都士兰的注册资本将变更为 70,000 万元。

五、 本次增资的目的及对公司的影响

本次增资有利于提高公司资产质量，降低项目投资成本，促进募投项目顺利实施，有利于加快发展募集资金各项业务，进一步提高市场占有率，增强持续盈利的能力，提升公司核心竞争力。

六、 备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日